

3D パッケージソリューション

3D PACKAGING

銅核ボール

受動部品実装

- 溶剤洗浄 Type5 ソルダペースト M10-PHW
- 補充用ソルダブリフォーム Chip Solder 0402
- ハロゲンフリー樹脂接着剤に入りはんだ CBF

パッケージング

- 耐熱疲労と耐落下衝撃性を両立 ソルダボール M770
- 高耐熱疲労ソルダボール M60
- 形状保持力の高い 銅核ボール
- POP 用ソルダペースト NSV300 シリーズ
- 接合補強用ソルダペースト JPP
- 低揮発水溶性フラックス WF-6317

部品内蔵実装

- 接合とスペース確保を両立する 銅核ボール
- 再溶融を防止するソルダペースト RAM シリーズ

半導体実装

- NWO 対策無洗浄ソルダペースト S101-S4-HF
- 無洗浄 Type5 ソルダペースト M705-RGS800HF

パンプ形成

- $\phi 100\mu\text{m}$ 以下 ソルダボール / LASボール M705 / M200
- $\phi 100\mu\text{m}$ 以下 銅核ボール / 銅ボール
- 転写用ソルダパウダー PPS
- 微小パンプ形成用ソルダペースト M200-BPS
- ボール形成用フラックス MB-T100

ボールアタッチ(ボール接続)

- POP 用ソルダペースト / フラックス NSV320 / NSV300
- 超低残渣フラックス 901K5
- 水溶性フラックス SPK-300 シリーズ
- 無残渣フラックス JPK8
- 銅ビラー用接合材料 PPS

製造装置

- 半導体実装用 Ne リフロー炉 SNR-1346MB